公司代码：688396 公司简称：华润微

华润微电子有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四、风险因素。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）；截至本报告披露日，公司总股本1,328,210,680股，预计派发现金红利总额为6,773.87万元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.26%。公司已于2025年10月17日完成2025年半年度权益分配，共计派发现金红利3,451.58万元。本年度公司拟分配现金红利总额10,225.45万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.48%。公司2025年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	华润微	688396	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴国屹	邓加兴
联系地址	江苏省无锡市梁溪路14号	江苏省无锡市梁溪路14号
电话	+86-510-85893998	+86-510-85893998
传真	+86-510-85872470	+86-510-85872470
电子信箱	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com	crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国领先的拥有芯片设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在功率半导体领域已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

目前公司主营业务可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。公司产品与方案业务板块聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制等领域。公司制造与服务业务主要提供半导体开放式晶圆制造、封装测试等服务。此外，公司还提供掩模制造服务。

2.2 主要经营模式

公司产品与方案板块业务目前主要采用IDM经营模式，同时制造与服务板块业务向国内外半导体企业提供专业化服务。

IDM模式是指包含芯片设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试在内全部或主要业务环节的经营模式。公司产品及方案板块采用IDM经营模式，主要原因为IDM模式在研发与生产的综合环节长期的积累会更为深厚，有利于技术的积淀和产品群的形成。另外，IDM企业具有资源的内部整合优势，在IDM企业内部，从芯片设计到制造所需的时间较短，不需要进行硅验证，不存在工艺对接问题，从而加快了新产品面世的时间，同时也可以根据客户需求进行高效的特色工艺定制。功率半导体领域由于对设计与制造环节结合的要求更高，采取IDM模式更有利于设计和制造工艺的积累，推出新产品速度也会更快，从而在市场上可以获得更强的竞争力。该模式对企业技术、资金和市场份额要求较高。公司主要经营模式如下：

1、产品与方案业务板块

（1）研发模式

针对产品与方案板块的开发，公司制定流程控制文件《新产品开发控制程序》。研发流程主要包括立项、设计、样品试制及评价、试生产和量产五个阶段，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。

①立项阶段：综合考量市场调研、客户需求、技术趋势等因素启动产品立项，立项评估报告包括市场可行性、技术可行性、工艺及生产可行性、财务可行性、项目计划及预算等方面。评估报告提交评审委员会评议通过后进入设计阶段。

②设计阶段：产品立项后，研发人员依据《设计开发技术评估报告》和《设计开发任务书》正式进入产品设计阶段，其中包括线路设计、版图设计、工艺设计及验证方案等步骤。在设计过程中，需要时可根据产品规模、设计难度等进行次数不定的设计审查。研发人员会围绕设计目标，进行芯片仿真、失效模式分析，确定产品的雏形，初步确定材料规格及工艺流程，进行单项工艺开发。产品设计方案经委员会评审通过后，将根据方案制作相应光刻版，准备工程批流片试验。

③样品试制及评价阶段：该阶段将依据产品性能与功能要求选择合适的设计验证流程。工程试验批在流通后对芯片进行中测评价与封装成品测试评价，若不达标则进行新一轮的工艺调整或版图调整，直至相关参数达标，同时进行可靠性评价、无有害物质评价、应用评价以及客户送样评价。样品通过上述全部评价后，进行扩批验证稳定性。在完成工艺流程固化、关键窗口拉偏完成、可靠性考核、客户认定通过等程序后，样品提交评审委员会评审，通过后进入试生产阶段。

④试生产阶段：研发人员继续优化改进产品，提升产品的良率，及时解决客户反馈，在达到一定产量后提交评审委员会评审，通过后进入量产阶段。

⑤量产阶段：运营中心按订单计划安排生产，工厂按照流程单、控制计划进行生产，在生产过程中各部门持续协同改进，通过技术革新与产品升级不断提升客户满意度。

（2）采购和生产模式

产品与方案板块依托公司全产业链制造资源，主要采取IDM经营模式经营，同时根据实际需要，对少量阶段性产能或工艺不匹配的生产环节选择进行外协加工生产。

IDM模式下，市场部门根据市场及客户需求制订销售计划，综合计划部根据销售计划制定生产计划，晶圆生产由公司制造中心完成，制造中心会根据内外部整体需求进行原材料采购计划。晶圆生产完成后通过公司封测平台进行封装测试。如有需要外协加工的情况，公司在严格遵选委外供应商的基础上，严格管理和跟踪外协加工全过程，保证产品的质量和性能要求，同时高度重视核心技术的保密工作。

（3）销售模式

公司产品与方案板块采取直销与经销相结合的模式，公司制定了《营销业务管理规定》《经销商通用规则》《市场部订单管理规定》等制度，具体规定和流程如下：

①接受订单与计划：市场部门将客户订单录入系统，包括产品规格型号、订购数量、价格、交货日期等，市场部门与运营中心根据库存情况确认可达成的交期，确认后对客户进行回复。市场部门根据客户提供的计划，提交运营中心，由运营中心按照需求组织制造生产。

②发货：对于款到发货的客户，公司确认收到客户的付款单后进行发货；对于授信客户，在授信条件内发货。发货时产品直接由公司发送至客户指定地点。

③开具发票：发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后将发票发送客户。

④对账及收款：公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

公司产品的终端客户数量众多，部分销售需要通过经销商提供销售渠道以及日常的客户维护工作。公司选定的经销商具有丰富的销售网络及深厚的客户积累，是公司客户的重要组成部分。公司对经销商管理建立并执行全套的严格管理措施，经销商需提供终端客户资料，签订《经销商通用规则》《销售协议书》，再进行送样、报价、接单交易，公司会不定期对经销商进行实地拜访和核实。公司一般通过经销区域范围、客户资源、推广能力、技术支持、资金实力等方面综合考察经销商。公司主要经销商皆为行业内知名经销商，具有较强的营销管理能力，同时自身的技术水平和团队也能为终端客户提供一定的售前和售后技术支持服务，从而有效地满足终端客户的需求。

2、制造与服务业务板块

（1）研发流程

公司制造与服务板块工艺技术研发遵循业界标准的研发流程，具体包括立项评估、工程开发、产品验证、试生产、量产等重要环节，每个阶段均有专门的评审委员会进行评审。公司制造与服务板块工艺技术研发简要流程如下：

①立项评估阶段：市场部门根据市场及客户发展需求以及公司产品发展战略需求，确立工艺技术发展目标，在公司内产、销、研等部门展开全面立项评估，针对市场、商业、技术、生产、财务等维度进行量化打分，最终由评审委员会进行评议后确定是否立项，并明确项目目标与负责人。

②工程开发阶段：基于立项需求及项目目标，项目负责人在公司范围内成立项目团队，规划项目开展计划与配套资源，组织实施项目研发工作。以晶圆制造为例，具体技术开发流程包括工艺物理设计规则文件定义、工艺流程架构定义、器件架构及参数目标定义、工程开发阶段工程掩模版的规划与制作、工程试验方案的制定与流片、工艺及器件开发结果测试与评价等工作。工艺及器件开发达标后，研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审阶段技术交付。通过技术评审后，由市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一研发阶段。

③产品验证阶段：基于工程开发阶段交付，由研发中心完成器件模型参数提取与设计服务套件文件建立，并提交给设计单位进行相应产品设计。产品导入后由研发中心开展产品工程流片并保证工艺及器件参数达标。产品功能验证评价由设计单位负责，研发中心配合进行工程改善以及产品工程窗口验证。产品验证达标后，由研发中心负责总结阶段成果并提交评审委员会评审技术交付。通过技术评审后，市场部门结合市场及客户发展状况判定项目是否具备进入试生产阶段的条件。

④试生产阶段：通过工艺平台可靠性考核及客户产品可靠性考核，客户产品进入小批量生产阶段。该阶段主要包括产品良率提升、生产工艺能力提升、生产产能拓展等工作。产品试生产各项交付指标达标后，研发中心负责总结阶段成果，并提交评审委员会评审。通过技术评审后，公司结合市场及客户发展状况判定项目是否进入下一阶段。

⑤量产阶段：运营中心主要负责产品生产，并管控产品良率提升、生产能力改进、生产效率提升等工作，使研发效益最大化。

（2）采购模式

公司制造与服务板块主要采用“以产定采”的采购模式。晶圆制造服务主要采购原材料有硅片、化学品等；封装测试服务主要采购原材料有引线框、塑封料等。同时，公司采购部门会根据市场供应情况、价格变化情况及供应商交货周期等因素，结合生产计划对主要的原材料，进行适当的安全库存备货。

公司采购方式分为招标采购方式和非招标采购方式，公司经过多年发展，已和多数主要原材料供应商建立了良好的合作关系，建立了合格供应商名录，采购部门按采购计划在《合格供应商名录》中选择合格供应商进行采购。采购部门会根据采购类别和采购金额选择相应的采购方式，并与供应商签订相应的采购合同，内容包括采购金额、数量和供货日期等，货物经质检验收后入库。

（3）生产模式

公司具备完善的生产运营体系，由运营中心综合考虑市场需求、原材料供应和产能情况制定生产计划。

对于晶圆制造业务，在接到客户的产品订单后，公司首先根据客户的需求确定客户产品所需的制程、规格并制定工艺路线和工艺流程等相关资料。综合计划部负责制造生产过程控制，订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产系统方面的技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造部门负责落实生产。对于新客户或是新产品，制造中心与研发中心将协同公司相关部门进行立项评审，确定产品开发项目及相关的工艺路线、工艺流程，安排流片实验并完成相关的技术测试分析、封装测试分析、客户试用评估、可靠性考核评估等新品综合实验。通过客户验证评估后，公司对新产品进行试生产、小批量生产以评估产品的稳定性、一致性以及是否具备量产所需的工艺窗口。通过这些验证后，产品可以开始根据客户需求进入量产。公司质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

对于封装测试业务，公司生产流程如下：客户有新产品封装测试需求，公司将先评估封测是否能承接并安排工程试验批，流程通过后进入量产阶段。客户提供封测代工需求计划，综合计划部依据产能情况评估计划承接量。公司在接到客户订单并收到客户圆片后，进行生产安排，并负责管理订单交期确认、生产计划安排、订单交付等事项。在具体的生产过程中，综合计划部负责封测生产过程控制、订单交期确认和生产计划安排，智能与信息化部负责提供生产自动化及生产支持系统方面等技术支持，质量管理部评价产品质量控制能力并提出质量控制方案，订单通过评审后由制造中心负责落实生产，质量管理部负责各环节产品质量的跟踪检测，所有产品经质量管理部验收合格后才会交付给客户。

（4）销售模式

目前公司制造与服务板块以直销作为主要销售方式，由市场部门负责销售管理，公司制造与服务板块主要客户是半导体企业，公司与国内众多半导体企业建立了稳定的合作关系，并与其在产品交期、质量控制、交货方式、付款方式等方面形成了标准化、系统化、合同化约束，客户一般会与公司签订框架性合同，根据具体的生产计划以订单方式向公司发出采购计划，公司生产完成后发货。发货后，系统根据发货单自动生成销售发票，市场部门审核后将发票发送客户。公司会每月与客户进行对账确认，对于授信客户，市场部门按照相应的授信账期在发货后跟踪货款结算情况，以保证按期收款。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）半导体行业

2025年，我国持续强化半导体行业的战略核心地位，扶持政策迭代升级，精准发力破解产业发展瓶颈，为半导体产业高质量发展持续注入政策动能。继2024年多项重磅政策落地后，2025年相关部门进一步完善政策体系，聚焦技术攻关、产能提升、人才培育和产业链配套，推动产业自主可控进程加速。2025年3月，工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2025—2026年高质量发展行动方案》，明确提出聚焦集成电路核心领域，加大对先进制程、关键材料和设备的研发投入，落实集成电路企业研发费用加计扣除比例提升政策，助力企业降低研发成本、提升创新能力；同时，优化产业布局，推动长三角、珠三角、京津冀等半导体产业集群提质增效，强化产业链上下游协同联动。2025年5月，教育部、工信部联合发布《集成电路人才培养提质行动计划》，扩大集成电路相关专业招生规模，推进校企合作、产教融合，搭建人才培养与产业需求对接平台，缓解行业高端人才短缺困境。2025年7月，税务总局、财政部进一步细化集成电路企业税收优惠政策，对符合条件的先进制程芯片企业、半导体设备制造企业给予增值税即征即退、企业所得税减免等支持，进一步优化产业发展营商环境。此外，资本市场对半导体产业的支撑力度持续加大，科创板进一步完善半导体企业上市审核机制，鼓励具备核心技术的半导体中小企业上市融资，为产业技术攻关提供资金保障，推动产业链供应链韧性和安全水平持续提升。

2025年全球半导体市场延续增长态势，在人工智能、高性能计算（HPC）、新能源汽车等下游需求的强劲拉动下，市场规模持续攀升。尽管2024年已形成较高基数，但全球半导体行业仍实现增速提升，整体呈现加速增长、结构分化的发展特征。世界半导体贸易统计组织WSTS发布数据（2026年3月）显示，2025年全球半导体市场规模同比增长26.2%，达到7,956亿美元，其中各细分品类呈现差异化增长态势，模拟芯片触底回升态势明显，同比增长7.5%，逐步回归稳健增长轨道；美国半导体行业协会（SIA）披露，2025年全球半导体销售额达7,917亿美元，同比增长25.6%，但仍保持两位数增长；Gartner的统计结果显示，2025年全球半导体收入总额达7,930亿美元，同比增长21%，其中AI相关芯片成为拉动增长的核心动力。尽管各机构统计数据存在细微差异，但均清晰表明，2025年全球半导体市场已从2024年的爆发式复苏转向稳健增长，行业发展韧性凸显，细分领域的增长潜力持续释放。区域市场方面，亚太地区凭借消费电子、汽车电子的稳定需求，同比增长45.4%，成为全球增长最快的区域；美洲市场依托AI芯片需求爆发与数据中心建设加速，同比增长31.4%；中国市场加速复苏，在政策扶持和技术突破双重驱动下，同比增速达17.9%，成为业太市场增长的核心引擎；欧洲市场依托本土核心企业的技术优势，实现温和增长，同比增速分别为6.7%，逐步摆脱此前低迷态势。

2025年，我国工业经济持续稳健运行，产业发展韧性进一步增强，为半导体产业发展提供了坚实支撑。全年规模以上工业增加值同比增长5.9%，电子信息制造业增加值同比增长10.6%，显著高于整体工业增速，产业发展态势良好。据工信部统计，2025年我国集成电路产量达4,842.8亿块，同比增长10.9%，其中22纳米-40纳米主流制程产能占比突破30%，较2024年大幅提升，产能结构持续优化，芯片自给能力进一步增强。据海关总署统计，2025年我国集成电路进口总额达30,355.4亿元，进口量为5,917亿块，同比分别增长10.1%和7.8%，进口结构持续优化，高端芯片进口依赖度逐步降低；出口总额达14,442亿元，出口量为3,495亿块，同比分别增长27.4%和17.4%。2025年，我国集成电路产业在产量、进出口等方面的稳步增长，充分反映出产业规模持续壮大、核心竞争力不断提升，在全球半导体产业链中的地位进一步凸显。

（2）功率半导体行业

根据Omdia最新统计，2025年全球功率半导体市场规模预计为755亿美元。中国是全球最大的功率半导体消费国，2025年中国功率半导体市场规模达291亿美元，占全球份额38.6%，市场规模持续增长。预计2028年中国功率半导体市场规模有望达到381亿美元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据Omdia 2025年10月的统计，公司在中国功率半导体企业排名第二、中国MOSFET厂商中规模排名第一。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）第三代半导体材料带来发展新机遇

第一代半导体材料以硅、锗等单质为主，广泛应用于传统电子领域；第二代半导体材料以砷化镓、铟化铟等化合物为核心，主要服务于通信、光电等细分场景；第三代半导体材料属于宽禁带半导体材料，其中SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）是当前产业化应用最成熟、市场需求最旺盛的两大核心品类。与传统硅基半导体材料相比，第三代半导体材料凭借更宽的禁带宽度，可在更高温度、更强电压、更快开关频率下稳定运行，核心性能优势显著。其中，SiC具备高临界磁场、高电子饱和速度及极高热导率的特性，其器件开关损耗较硅器件大幅降低，可用于制造高耐压、大功率电力电子器件（如MOSFET、IGBT、SBD等），广泛适配智能电网、新能源汽车、光伏储能等高频高温应用场景；GaN则拥有高临界磁场、高电子饱和速度及极高电子迁移率的优势，是超高频器件的核心选择，主要应用于5G通信、微波射频、AI服务器电源等领域。

2025年，第三代半导体材料迎来规模化应用关键一年，生产技术持续突破推动成本稳步下降，应用场景不断拓宽，产业发展进入加速期。据行业数据显示，2025年全球SiC MOSFET芯片及模块市场规模已达101.19亿元，中国市场占比22.1%，约22.4亿元，其中SiC驱动芯片作为关键配套部件，占SiC器件整体市场的15%-20%，对应全球市场规模约15-20亿元，中国市场规模达3-4.5亿元。在新能源汽车领域，800V高压平台成为主流，每辆新能源汽车SiC驱动系统需配套3-6颗驱动芯片，单车价值量达数百元，直接带动SiC需求爆发；光伏与储能领域，1500V光伏逆变器采用SiC方案后，驱动芯片需求增加30%，2025年全球光伏领域SiC驱动芯片需求超千万颗。同时，Omdia最新数据显示，在混合动力汽车、新能源汽车、电源及光伏逆变器等下游需求持续拉动下，全球SiC和GaN功率半导体市场保持高速增长，2025年市场规模已突破80亿美元，预计未来五年仍将保持两位数年均复合增长率，2030年将超过175亿美元，持续为半导体行业注入新的增长动能。

（2）新兴科技产业的发展孕育新的市场机会

2025年，物联网、5G通信、人工智能、新能源等新兴科技产业持续成熟，推动消费电子、工业控制、汽车电子、光伏储能等半导体下游核心行业加速升级，下游市场的革新迭代为半导体产业带来广阔市场空间，成为行业增长的核心驱动力。

在汽车电子领域，2025年全球新能源汽车渗透率持续提升，带动汽车半导体需求持续攀升。相较于传统燃油车，新能源汽车对传感器、制动集成电路、功率半导体的需求大幅增加，单车半导体价值量已达传统汽车的2.5倍，其中功率半导体用量占比从2024年的52%进一步提升至58%以上。在功率模块领域，国产替代动能凸显，SiC功率模块装机量同比大幅增长，1500V高耐压模块批量装车，适配高端车型。

在新能源光伏领域，受益于全球“碳达峰、碳中和”目标推进及清洁能源加速应用，2025年全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，光伏逆变器的升级换代直接带动功率半导体需求增长，尤其是SiC器件在1500V光伏逆变器中的应用逐步普及，成为行业主流方案。在人工智能领域，AI大模型快速迭代推动数据中心建设提速，对高效电源管理、散热系统及高频半导体器件的需求持续激增，为功率半导体、逻辑芯片、存储芯片提供了新的应用场景，成为半导体行业新的增长亮点。与此同时，国内半导体企业技术研发实力持续增强，在多个细分领域实现突破，逐步切入全球供应链，借助新兴科技产业发展契机，推动国内半导体产业实现高质量发展。

（3）服务器板级电源管理芯片的发展现状与未来趋势

2025年，服务器板级电源管理芯片作为数据中心、云计算及AI基础设施的核心器件，在市场需求、技术革新及政策扶持的多重推动下，实现高速发展，市场规模持续扩大，技术迭代速度进一步加快，成为半导体行业最具增长潜力的细分领域之一。

市场层面，2025年全球电源管理芯片市场规模达550亿美元，中国市场规模达3,431亿元人民币（约235亿美元），占据全球38%份额，年均复合增长率16.1%，远超全球平均水平。其中，服务器领域电源管理芯片需求占比显著提升，尤其是AI服务器电源芯片市场增长迅猛，据TrendForce预估，2025年全球AI服务器出货量约246万台，同比增长24.3%，2025-2027年AI服务器电源市场将实现指数级增长，规模从74亿美元升至325亿美元，年复合增长率达110%。中国电源管理芯片市场中，数字电源管理芯片在数据中心领域应用增速最快，成为驱动市场增长的核心力量。

技术层面，2025年服务器板级电源管理芯片朝着高效化、智能化、模块化方向加速迭代。为满足服务器能效优化需求，数据中心电能转换效率要求已提升至97%以上，SiC、GaN等宽禁带半导体材料的应用日益广泛，采用SiC的电源模块转换效率可达98%以上，有效降低能耗、提升功率密度。同时，AI算法与电源管理技术深度融合，通过动态负载预测与自适应调压，结合数字孪生技术优化电源调度，进一步提升电源利用效率；在OCP ORv3等标准推动下，供电架构向集中化升级，PSU功率提升至22kW以上，输出电压升至400V，降低传输损耗与线缆体积。此外，随着5G和物联网的持续扩展，边缘服务器对小型化、高可靠电源芯片的需求激增，驱动芯片设计向模块化、定制化发展，国内企业推出的大电流DrMOS、多相控制器等产品，已在客户端实现量产爬坡，部分产品性能达到国际先进水平。

政策与产业层面，绿色数据中心相关政策持续推进，加速高效电源管理芯片的普及应用；国内半导体产业扶持政策持续落地，推动本土企业在电源管理芯片领域的技术突破，当前国内服务器电源芯片国产替代率已达10%-20%，国产替代进程持续提速。未来，随着AI服务器、边缘计算设备的持续普及，以及国产芯片技术的不断成熟，服务器板级电源管理芯片市场规模将持续扩大，高效化、智能化、国产化将成为核心发展趋势，为国内半导体企业带来广阔的发展空间。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	30,589,736,143.75	29,106,829,546.42	5.09	29,215,259,820.18
归属于上市公司股东的净资产	22,980,615,878.80	22,306,213,072.76	3.02	21,558,056,748.30
营业收入	11,053,792,007.48	10,118,525,841.56	9.24	9,900,603,859.18
利润总额	722,393,334.60	794,634,992.46	-9.09	1,686,760,848.47
归属于上市公司股东的净利润	660,543,164.52	762,459,866.87	-13.37	1,479,265,748.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,089,826.59	643,657,436.40	-26.81	1,126,623,096.14
经营活动产生的现金流量净额	2,084,735,426.01	2,035,987,182.21	2.39	1,737,665,674.14
加权平均净资产收益率(%)	2.9102	3.4673	减少0.56个百分点	7.1494
基本每股收益（元/股）	0.4979	0.5765	-13.63	1.1206
稀释每股收益（元/股）	0.4978	0.5760	-13.58	1.1187
研发投入占营业收入的比例(%)	10.57	11.53	减少0.96个百分点	11.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,354,709,996.80	2,863,468,758.56	2,850,687,238.79	2,984,926,013.33
归属于上市公司股东的净利润	83,216,566.09	255,578,783.84	186,709,060.22	135,038,754.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,936,221.37	208,550,918.14	121,449,531.31	76,153,155.77
经营活动产生的现金流量净额	270,998,538.92	441,966,991.19	648,942,223.74	722,827,672.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,934
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华润集团(微电子)有限公司	0	878,982,146	66.21	0	无	0	国有法人
王开斌	2,814,610	21,126,489	1.59	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-14,527,241	20,729,675	1.56	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,296,760	20,101,980	1.51	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-2,791,634	19,361,993	1.46	0	无	0	其他
白秀平	1,870,873	16,563,237	1.25	0	无	0	境内自然人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-13,232,836	13,232,839	1.00	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	649,939	12,049,643	0.91	0	无	0	其他
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	-1,719,218	12,005,465	0.90	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-391,430	8,840,167	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知是否存在关联关系				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

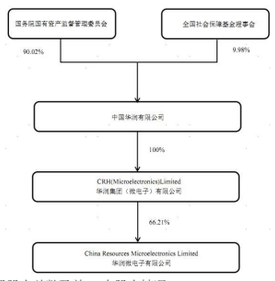
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入110.54亿元，较去年同期增长9.24%；实现归属于母公司所有者的净利润6.61亿元；报告期末公司总资产为305.90亿元，归属于母公司所有者权益为229.81亿元。

报告期内，公司积极开拓市场，持续优化产品结构，保持了较高的产能利用率，营业收入有所增长；但公司参股的两条12吋生产线项目，其中重庆12吋处于产能完成爬坡和收入逐步增长的阶段，另外深圳12吋处于产能爬坡的阶段，重资产投资所带来的折旧对公司利润指标造成了一定影响。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2026-012

华润微电子有限公司 2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.051元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的扩充发展阶段等因素的综合判断。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，华润微电子有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币33,868.13万元。根据《开曼群岛公司法》和公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的规定，经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,328,210,680股，以此计算合计拟派发现金红利6,773.87万元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.26%。公司已于2025年10月17日完成2025年半年度权益分派，共计派发现金红利3,451.58万元。本年度公司累计拟分配现金红利总额10,225.45万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	102,254,509.03	76,996,705.08	147,969,201.05
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	660,543,164.52	762,459,866.87	1,479,265,748.53
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	338,681,336.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	327,220,415.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	967,422,926.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	327,220,415.16		
现金分红比例(%)	33.82		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	3,489,666,777.87		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	31,072,921,708.22		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	11.23		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润660,543,164.52元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）为102,254,509.03元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.48%，本年度现金分红比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位，公司需要长期保持大规模研发投入以缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此，公司为